

南京晶升装备股份有限公司
2023年7月投资者关系活动记录表

证券简称：晶升股份 股票代码：688478 编码：〈2023-003〉

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研； <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访； <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会； <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观； <input type="checkbox"/> 其他：
参与单位名称	兴全基金、恒越基金、嘉实基金、中银基金、国泰基金、广发证券、中信证券、华泰证券、东北证券、中再资产、新华资产、汇添富基金、路博迈基金
时间	2023年7月
地点	南京晶升装备股份有限公司会议室及董事长办公室
公司接待人员姓名	董事长、总经理：李辉；董事会秘书、财务负责人：吴春生
投资者关系活动主要内容介绍	问答环节 Q: 如何看碳化硅未来的国际竞争格局？ A: 我们看到，在碳化硅衬底方面，中国部分龙头企业已取得阶段性的技术进步，并获得了国际器件大厂的认证。虽然衬底的良率仍然有待提升，但对中国碳化硅行业来说，这无疑是一个从0到1的里程碑式的突破。今后只要我们不断研究、奋起直追，中国碳化硅行业必会迎来从1到10，从10到100的爆发性飞跃，而中国厂商也必将在未来碳化硅市场中占据重要地位。 Q: 依照以往规律，半导体行业一般自下而上复苏，芯片设计端已经逐渐启动，从公司角度来看，设备端是否开始有回暖迹象？ A: 公司目前已经开始执行客户前期要求延期交付的订单，后续客户的新增计划正在等待确认中。 Q: 公司是否已经布局液相法碳化硅长晶体炉？ A: 关于液相法碳化硅晶体生长设备，公司提前开展了相关布局并

已经提供样机给多家客户，目前我们正积极协同客户不断进行优化和改进，进一步提升晶体的品质与良率。

Q:公司已供应的半导体级单晶硅炉以什么尺寸为主?

A:在半导体级单晶硅炉方面，公司以12英寸设备率先打开市场，12英寸的销售占比较高。同时公司设备也已经覆盖了8英寸的高端轻掺硅片制备。

Q:轻掺与重掺的技术区别体现在哪里?

A:由于轻掺与重掺的掺杂不同，各自的生长工艺制程存在一定差异，因此对于晶体生长设备的气路设计，控制系统设计等方面也会提出不同的要求。

Q:公司产品主要以定制化为主，请问如何储备库存?

A:公司根据客户的差异化需求，进行定制化设计及生产制造。同时技术团队会不断优化设计方案，进行产品的标准化管理，包括设备零部件的通用化。对于通用的核心关键件我们会提前进行储备，这样也有助于更好地降低公司的采购成本并缩短采购周期。

Q:公司碳化硅长晶设备是否可以用于800V车用功率器件衬底的生产?

A:公司部分客户的产品已得到了下游厂商的验证，良率水平也在进一步提升中。

Q:目前影响公司产能的因素有哪些?

A:公司以研发设计为主，不直接从事产品基础零部件的生产加工。非标准零部件由第三方供应商根据公司设计方案定制加工完成后供应，公司随后进行部件和整机的装配、检测和调试等工作。因此，目前可能对公司产能产生影响的有供应链交付、装配场地及人员等因素。